



**深度*行业*半导体设备行业
2021 年业绩总结：部件紧缺
限制交付 订单能见度至
2023 年**



国际设备龙头 2021Q4 营收维持近 2 年的次高水平且显著高于历史记录，表明半导体设备行业需求仍保持旺盛态势。本轮半导体设备景气度周期是全球经济数字化快速转型、供应链紧缺、工艺节点演进等因素推动，景气度较高且具备持久性，设备厂商拥有充裕在手订单以保持后续经营快速增长。

报告要点

台积电大幅上调 2022 资本开支，半导体设备出货金额保持历史高位。台积电计划在 2022 年将资本支出提升至 400-440 亿美元，同比增加 1/3 至接近 1/2，其中约 70%-80% 将用于包括 2nm、3nm、5nm 和 7nm 的先进工艺技术研发。此外据 SEMI 统计，12 月北美半导体设备商出货金额仅较 11 月的历史高位小幅下滑 0.5%，同比增长 46.1%，处于历史次高水平。台积电的营收能力续创新高且大幅提升资本开支，北美半导体设备出货金额保持历史高位，表明半导体产业链景气度仍在持续。

全球半导体设备龙头公司收入 2021Q4 同比约增长 25.9%，全年增长 34%。由于 AMAT、TEL、ASMI 尚未公布 2021Q4 财报，按照 AMAT、TEL 的业绩指引中值和 ASMI 近 3 季度营收均值计算，8 家全球半导体设备上市企业 2021 年 Q4 合计收入 258.2 亿美元，同比增长 25.9%，营收仍处于高增长态势。全年来看，全球半导体设备上市企业销售收入超过 1000 亿美元，同比增长 34%。

LamResearch 紧追 TEL，KLA、ASML 收入保持行业增速。按营业收

入规模排序依次是 AppliedMaterials、ASML、TEL、LamResearch、KLA、DNS，其中 LamResearch 与 TEL 的收入基本上持平，而 KLA 预计 2022 年再增长 20% 将接近 100 亿美元收入规模，而 ASML 2021 年新接订单 262 亿欧元，同比增长 133%。

半导体零部件企业收入增速慢于整机企业。据统计 UCT、Ichor、MKS、AE 等国际半导体零部件企业收入规模，2021 年三、四季度收入同比增长 22%、22%，慢于行业平均增速 30% 以上，导致全球零部件供不应求，整机交付受到一定的制约。

中国大陆仍然是全球主要半导体设备市场之一。根据 AMAT、ASML、KLA、Lam、DNS、TEL 等数据，2021Q3 来自中国大陆的半导体设备销售收入为 47.21 亿美元，占比 26%，环比小幅下降 5 个百分点，近 4 个季度维持在 25%-30% 区间，与中国台湾地区持平，高于韩国。

普遍具有优质在手订单。据 KLA、Lam、ASML 等公司的 2021Q4 业绩说明会上表明，在手订单充足且部分能见度至 2023 年，后续零部件供应恢复正常供应有望加速订单落地并形成收入增长，且中微公司、盛美上海等国内半导体设备商在业绩预告中表明在手订单充足或出货量同比翻倍，后续订单确认收入有望延续高增长。

A 股半导体设备公司 2021 年业绩亮眼，营收和盈利能力均显著提升。

2021Q4/2021 全年，A 股半导体设备公司营收普遍呈现 30%+ 至 150%

的营收高增长态势，净利润也有接近或超过翻倍的表现。展望 2022Q1 和 2022 全年，全球各地区正努力建设区域化晶圆产能以迎接数字化经济大浪潮。据全球主要半导体设备商的观点表明，零部件紧缺情况有望延续至 2022 下半年，在手订单水平处于历史高位，零部件商和半导体设备商仍有望在 2022-2023 年长期持续受益。

重点推荐

全球半导体设备行业景气度保持历史高位，ASML、LamResearch、AMAT 等对 2022 年行业增长及订单预期普遍乐观。

A 股半导体设备推荐组合：盛美上海、精测电子、中微公司、北方华创、万业企业、芯源微、华峰测控、长川科技、晶盛机电、江丰电子、新莱应材、神工股份。

评级面临的主要风险

晶圆厂建设慢于预期；国际地缘政治摩擦不确定性；零部件供应紧缺加剧。

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_37254

